

# 吉林CMOS键合机

生成日期: 2025-10-13

**EVG®805解键合系统用途:** 薄晶圆解键合EVG805是半自动系统, 用于剥离临时键合和加工过的晶圆叠层, 该叠层由器件晶圆, 载体晶圆和中间临时键合胶组成。该工具支持热剥离或机械剥离。可以将薄晶圆卸载到单个基板载体上, 以在工具之间安全可靠地运输。特征: 开放式胶粘剂平台解键合选项: 热滑解键合解键合机械解键合程序控制系统实时监控和记录所有相关过程参数薄晶圆处理的独特功能多种卡盘设计, 可支撑最大300mm的晶圆/基板和载体高形貌的晶圆处理技术数据晶圆直径(基板尺寸)晶片最大300mm高达12英寸的薄膜组态1个解键合模块选件紫外线辅助解键合高形貌的晶圆处理不同基板尺寸的桥接能力GEMINI FB XT采用了新的Smart View NT3键合对准器, 是专门为<50 nm的熔融和混合晶片键合对准要求而开发的。吉林CMOS键合机

**EVG501**  
**晶圆键合机**



岱美仪器技术服务(上海)有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

**EVG®850键合机** EVG®850键合机特征 生产系统可在高通量, 高产量环境中运行 自动盒带间或FOUP到FOUP操作 无污染的背面处理 超音速和/或刷子清洁 机械平整或缺口对准的预键合 先进的远程诊断 技术数据 晶圆直径(基板尺寸) 100-200、150-300毫米 全自动盒带到盒带操作 预键合室 对准类型: 平面到平面或凹口到凹口 对准精度 $X \pm 50\mu\text{m}$   $Y \pm 50\mu\text{m}$   $\theta \pm 0.1^\circ$  结合力: 最/高5N 键合波起始位置: 从晶圆边缘到中心灵活真空系统 $9 \times 10^{-2}\text{mbar}$ (标准) 和 $9 \times 10^{-3}\text{mbar}$ (涡轮泵选件) 清洁站 清洁方式: 冲洗(标准), 超音速喷嘴, 超音速面积传感器, 喷嘴, 刷子(可选) 腔室: 由PP或PFA制成(可选) 清洁介质: 去离子水(标准)  $\text{NH}_4\text{OH}$  和  $\text{H}_2\text{O}_2$ (最/大)。2%浓度(可选) 旋转卡盘: 真空卡盘(标准) 和边缘处理卡盘(选件), 由不含金属离子的清洁材料制成 旋转: 最/高 $3000\text{rpm}$   $5\text{s}$  进口键合机实际价格EVG501 晶圆键合机系统: 真正的低强度晶圆楔形补偿系统, 可实现高产量; 研发和试生产的低购置成本。

**EVG540**  
**全自动晶圆键合机**



岱美仪器技术服务（上海）有限公司  
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®501键合机特征：独特的压力和温度均匀性；兼容EVG机械和光学对准器；灵活的研究设计和配置；从单芯片到晶圆；各种工艺（共晶，焊料TLP直接键合）；可选的涡轮泵 $<1E-5\text{mbar}$ 可升级用于阳极键合；开室设计，易于转换和维护；兼容试生产，适合于学校、研究所等；开室设计，易于转换和维护 $200\text{mm}$ 键合系统的最小占地面积：0.8平方米；程序与EVG的大批量生产键合系统完全兼容EVG®501键合机技术数据最大接触力为 $20\text{kN}$ 加热器尺寸150毫米200毫米最小基板尺寸单芯片100毫米真空标准：0.1毫巴可选 $1E-5\text{mbar}$

EVG®520IS晶圆键合系统■拥有EVG®501和EVG®510键合机的所有功能■ $200\text{mm}$ 的单个或者双腔自动化系统■自动晶圆键合流程和晶圆替代转移■集成冷却站，实现高产量EVG®540自动键合系统■ $300\text{mm}$ 单腔键合室■自动处理多达4个键合卡盘■模块化键合室■自动底侧冷却EVG®560自动晶圆键合系统■多达4个键合室，满足各种键合操作■自动装卸键合室和冷却站■远程在线诊断■自动化机器人处理系统，用于机械对准的自动盒式磁带晶圆键合■工作站式布局，适用于所有键合工艺的设备配置EVG®GEMINI®自动化生产晶圆键合系统在最小的占地面积上，同时利用比较/高精度的EVG SmaiewNT技术，前/列的GEMINI大批量生产系统，并结合了自动光学对准和键合操作。有关更多详/细信息，请参/阅我们的GEMINI手册EVG键合机顶部和底部晶片的duli温度控制补偿了不同的热膨胀系数，实现无应力键合和出色的温度均匀性。

**EVG520 IS**  
**晶圆键合机**



岱美仪器技术服务（上海）有限公司  
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG键合机加工结果 除支持晶圆级和先进封装3D互连和MEMS制造外EVG500系列晶圆键合机（系统）还

可用于研发，中试或批量生产。它们通过在高真空，精确控制的准确的真空，温度或高压条件下键合来满足各种苛刻的应用。该系列拥有多种键合方法，包括阳极，热压缩，玻璃料，环氧树脂UV和熔融键合EVG500系列基于独特的模块化键合室设计，可实现从研发到大批量生产的简单技术转换。模块设计 各种键合对准（对位）系统配置为各种MEMS和IC应用提供了多种优势。使用直接（实时）或间接对准方法可以支持大量不同的对准技术。晶圆键合机系统 EVG®520 IS拥有EVG®501和EVG®510键合机的所有功能200 mm的单个或双腔自动化系统。进口键合机实际价格

烘烤/冷却模块-适用于GEMINI用于在涂布后和键合之前加工粘合剂层。吉林CMOS键合机

长久键合系统 EVG晶圆键合方法的引入将键合对准与键合步骤分离开来，立即在业内掀起了市场革命。利用高温和受控气体环境下的高接触力，这种新颖的方法已成为当今的工艺标准EVG的键合机设备占据了半自动和全自动晶圆键合机的主要市场份额，并且安装的机台已经超过1500个EVG的晶圆键合机可提供最/佳的总拥有成本TCO并具有多种设计功能，可优化键合良率。针对MEMS3D集成或gao级封装的不同市场需求EVG优化了用于对准的多个模块。下面是EVG的键合机EVG500系列介绍。

吉林CMOS键合机

岱美仪器技术服务（上海）有限公司位于金高路2216弄35号6幢306-308室，拥有一支专业的技术团队。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展EVG,Filmetrics, MicroSense, Herz, Herzan, Film Sense, Polyteknik, 4D, Nanotronics, Subnano, Bruker, FSM, SHB的品牌。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于磁记录、半导体、光通讯生产及测试仪器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易、转口贸易，商务信息咨询服务 的发展和创新，打造高指标产品和服务。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪，从而使公司不断发展壮大。